

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年 7月31日
【会社名】	株式会社テラプローブ
【英訳名】	Tera Probe, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 渡辺 雄一郎
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目 7 番17号
【電話番号】	(045) 476 - 5711
【事務連絡者氏名】	執行役員CFO 神戸 一仁
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目 7 番17号
【電話番号】	(045) 476 - 5711
【事務連絡者氏名】	執行役員CFO 神戸 一仁
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

## 1【提出理由】

当社は、平成25年7月30日開催の取締役会において、当社と株式会社テラミクロスが合併（以下「本合併」）することを決議し、同日付で合併契約を締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の3の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 当該吸収合併の相手会社に関する事項

商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	株式会社テラミクロス
本店の所在地	東京都青梅市今井三丁目10番地の6
代表者の氏名	代表取締役社長 渡辺 雄一郎
資本金の額	300百万円（平成25年3月31日現在）
純資産の額	1,032百万円（平成25年3月31日現在）
総資産の額	3,707百万円（平成25年3月31日現在）
事業の内容	半導体パッケージの開発、製造、販売

最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

	平成23年3月期	平成24年3月期	平成25年3月期
売上高（百万円）	-	2,772	4,261
営業利益（百万円）	-	358	960
経常利益（百万円）	-	327	981
当期純利益（百万円）	-	858	624

大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

大株主の名称	株式会社テラプローブ
発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合	100%

提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	当社の100%子会社
人的関係	当社より役員5名を派遣しています。
取引関係	当社より半導体パッケージ製造を委託しており、当社は半導体テストを受託しております

### (2) 当該吸収合併の目的

半導体テストとウエハレベルパッケージを包括的に提供するターンキーサービスの充実を図ることで、事業基盤の強化を図り、グループ経営の効率化を推進するためであります。

### (3) 当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容その他の吸収合併契約の内容

吸収合併の方法

当社を存続会社とする吸収合併方式です。

吸収合併に係る割当ての内容

株式会社テラミクロスは当社の完全子会社であるため、本合併による新株式の発行及び資本金の増加はありません。

その他の吸収合併契約の内容

当社が、株式会社テラミクロスとの間で、平成25年7月30日付で締結した吸収合併契約書の内容は、次のとおりです。

#### 吸収合併契約書

株式会社テラプローブ（以下「甲」という。）と株式会社テラミクロス（以下「乙」という。）とは、次のとおり吸収合併契約（以下「本合併契約」という。）を締結する。

#### 第1条（合併の方法等）

- 甲および乙は、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社として合併（以下「本合併」という。）し、甲が乙の権利義務の全部を承継する。
- 甲および乙の商号および住所は以下のとおりである。  
甲（吸収合併存続会社）株式会社テラプローブ 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目7番17号  
乙（吸収合併消滅会社）株式会社テラミクロス 東京都青梅市今井三丁目10番地の6

第2条（効力発生日）

本合併の効力発生日は2013年10月1日とする。但し、同日までに本合併に必要な手続を行うことができないときは、甲乙協議の上、効力発生日を変更することができる。

第3条（甲の金銭等の交付）

甲は、乙の発行済株式全部を所有しているため、本合併によって株式その他の金銭等の交付を行わない。

第4条（資本金の額に関する事項）

甲は、本合併に際して、本合併後の資本金の額を、増加しないものとする。

第5条（合併契約書の承認）

甲および乙は、本契約の締結日までに、本合併契約の締結につきそれぞれの取締役会で承認を得ていることを確認する。

第6条（権利義務全部の承継）

1. 乙は、甲の承認を得た2013年3月31日現在の会計帳簿・貸借対照表および財産目録その他同日現在の計算書を基礎とし、これに効力発生日の前日までの増減を加除した一切の資産、負債および権利義務を効力発生日において甲に引き継ぐものとする。
2. 乙は、2013年4月1日以降、本合併の効力発生日の前日に至る間に生じた資産、負債の変動については、別に計算書を添付して、その内容を甲に対して明示するものとする。

第7条（従業員）

甲は、本合併の効力発生日における乙の従業員を、すべて引き継ぐものとする。

第8条（善管注意義務）

甲および乙は、本合併契約の締結後、効力発生日まで、善良なる管理者の注意をもって、それぞれの財産の管理および業務の執行を行うものとする。

第9条（商号）

本合併により、甲の商号は変更されないものとする。

第10条（協議）

本合併契約に定めのない事項または本合併に関して協議すべき事項が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議のうえ、これを決定する。

以上、本合併契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。

2013年7月30日

神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目7番17号

甲 株式会社テラプローブ 代表取締役社長 渡辺 雄一郎

東京都青梅市今井三丁目10番地の6

乙 株式会社テラミクロス 代表取締役社長 渡辺 雄一郎

(4) 吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠

該当事項はありません。

- (5) 当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	株式会社テラプローブ
本店の所在地	神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目7番17号
代表者の氏名	代表取締役社長 渡辺 雄一郎
資本金の額	11,823百万円(予定)
純資産の額	19,543百万円(予定)
総資産の額	31,775百万円(予定)
事業の内容	半導体のテスト及びパッケージの開発、製造、受託、販売

以上